

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年9月17日(17.09.2020)



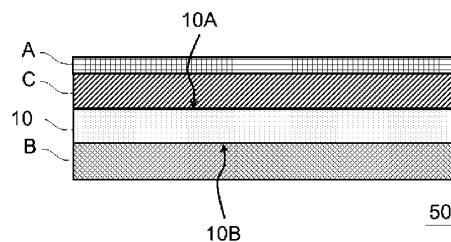
(10) 国際公開番号

WO 2020/184201 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 23/12 (2006.01) C09J 175/04 (2006.01)
C09J 123/00 (2006.01) C09J 183/04 (2006.01)
C09J 125/04 (2006.01) H01L 21/56 (2006.01)
C09J 133/00 (2006.01) C09J 7/38 (2018.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2020/008092
- (22) 国際出願日: 2020年2月27日(27.02.2020)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2019-046776 2019年3月14日(14.03.2019) JP
- (71) 出願人: 三井化学東セロ株式会社
(MITSUI CHEMICALS TOHCELLO, INC.) [JP/
JP]; 〒1018485 東京都千代田区神田美
土代町7 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 三浦 徹(MIURA Toru); 〒4570801 愛
知県名古屋市南区丹後通2-1 三井化
学東セロ株式会社内 Aichi (JP). 栗原 宏
嘉(KURIHARA Hiroyoshi); 〒4570801 愛知県
- 名古屋市南区丹後通2-1 三井化学東
セロ株式会社内 Aichi (JP).
- (74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI Shinji); 〒1410031
東京都品川区西五反田7丁目9番2号 K
DX五反田ビル9階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,

(54) Title: ELECTRONIC DEVICE PRODUCTION METHOD

(54) 発明の名称: 電子装置の製造方法



(57) **Abstract:** This electronic device production method at least comprises a preparation step for preparing a structure (100), and a sealing step for sealing an electronic component (70) using a sealing material (60). The structure (100) includes: an adhesive film (50) including a base material layer (10), an adhesive resin layer (A) that is provided to a first surface (10A) side of the base material layer (10) and used for provisionally immobilizing the electronic component (70), an adhesive resin layer (B) that is provided to a second surface (10B) side of the base material layer (10) and loses adhesiveness due to external stimulation, and an absorbent relief resin layer (C) that is provided between the base material layer (10) and the adhesive resin layer (A) or between the base material layer (10) and the adhesive resin layer (B); the electronic component (70) joined to the adhesive resin layer (A) of the adhesive film (50) and having a relief structure (75); and a support substrate (80) joined to the adhesive resin layer (B) of the adhesive film (50).

WO 2020/184201 A1

[続葉有]

TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

— 国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：基材層（１０）と、基材層（１０）の第１面（１０Ａ）側に設けられ、かつ、電子部品（７０）を仮固定するための粘着性樹脂層（Ａ）と、基材層（１０）の第２面（１０Ｂ）側に設けられ、かつ、外部刺激により粘着力が低下する粘着性樹脂層（Ｂ）と、基材層（１０）と粘着性樹脂層（Ａ）との間または基材層（１０）と粘着性樹脂層（Ｂ）との間に設けられた凹凸吸収性樹脂層（Ｃ）と、を備える粘着性フィルム（５０）と、粘着性フィルム（５０）の粘着性樹脂層（Ａ）に貼り付けられ、かつ、凹凸構造（７５）を有する電子部品（７０）と、粘着性フィルム（５０）の粘着性樹脂層（Ｂ）に貼り付けられた支持基板（８０）と、を備える構造体（１００）を準備する準備工程と、封止材（６０）により電子部品（７０）を封止する封止工程と、を少なくとも備える電子装置の製造方法。